

2012年12月

お得意様

セメダイン株式会社

展示会「ネプコンジャパン2013」出展のご案内

拝啓、

皆様におかれましては日頃セメダイン製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。弊社も来年の創業90周年を目指し、創業精神である新製品開発に日夜邁進しております。

さて、この度、首記展示会に本年に引き続きまして出展をいたします。2012年9月発売の弾性粘着剤セメダインBBX909をはじめ、現在開発中の新製品なども多数出品いたしますので、ご多忙中とは存じますが是非当社ブースにお立ち寄りくださるようお願い申し上げます。

敬具

<記>

1. 展示会名
ネプコンジャパン2013内「第4回先端電子材料EXPO(マテリアルジャパン)」
2. 会期
2013年1月16日(水)～18日(金)の3日間
3. 会場
東京ビックサイト(東京都)
4. 当社ブース
東館 東17-28
5. 出展内容
 - 1) 弾性粘着剤 セメダインBBX909(新製品)
“液体の粘着テープ”とも言える“貼ってはがせる弾性粘着剤”をコンセプトに、液体の特長である凹凸面の対応や設計の自由度、また粘着材の特長である仮止め用途や難接着材料用途に、そして弾性接着剤の特長である耐久性能などを生かした新しい粘着剤です。
 - 2) UV硬化形弾性接着剤 セメダインSX-UVシリーズ(開発品)
当社初のUV硬化形弾性粘接着剤シリーズ
不透明材料も接着できる画期的なUV粘接着剤で、硬化後はフレキシブルな弾性接着剤となり、異種材料の接着に最適です。
 - 3) PP専用弾性接着剤(開発品)
プライマーの要らないポリプロピレン専用の一液形弾性接着剤です。
接着の難しいポリプロピレンと各種材料の接着に最適です。

以上

ブースでお待ちしております、お気軽にお越しください。